

報道関係各位

2019年12月4日
日本アビオニクス株式会社
<http://www.avio.co.jp/>

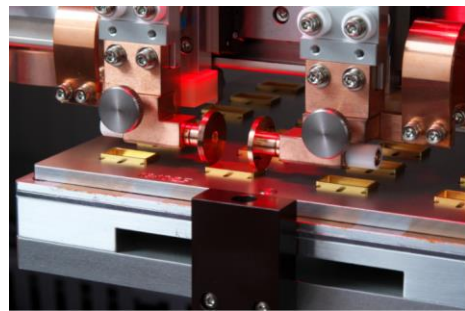
大型デバイスの金属パッケージ封止に対応 4KVA 業界最大の大容量電源でデバイス封止の剛性を向上 シーム封止装置【NAW-6100】を発売

金属パッケージのシーム封止装置で世界トップシェア※の日本アビオニクス株式会社（本社：東京都品川区、社長：竹内 正人）は、光通信デバイスやイメージングデバイス、ミラーデバイスなどの大型デバイスの金属パッケージ封止に対応した自動シーム封止装置【NAW-6100】を発売いたします。

※2019年8月当社調べ



NAW-6100



シーム封止風景

近年、5Gに関わる光ネットワークの増強や、基地局の増設などにより光通信デバイスの需要が増加しております。また、自動車の自動運転に使用されるLiDARのミラーデバイスにシーム封止が採用されることもあり、大型デバイスの金属パッケージ封止の需要も拡大しております。

本製品【NAW-6100】は従来のシーム溶接用電源を業界最大容量となる4KVAに拡大し、様々な大型デバイスに対応。厚みのあるLid（蓋）に対し十分なシール幅を確保して、封止の信頼性を向上します。また、小型デバイス封止で培った微細制御性能はそのまま、ワークにダメージの少ない高品質な封止も実現します。

今後、本溶接電源をインライン機に展開するとともに、さらなる高速化や信頼性の向上を追求し、お客様のニーズにお応えしていきます。

【製品特長】

1. 業界最大の大容量電源を搭載し、大型デバイス封止の品質を向上

4KVA、最大2次電流8000Aの大容量電源を搭載。発熱量を大きくすることで熱容量の大きい大型デバイス封止でも十分な溶け（シール）幅を確保し、リーク不良率の低減、接合強度の向上に寄与します。

これまで困難であった0.12mm以上の厚いLidを搭載するパッケージでも封止が可能になり、封止後のデバイスの剛性を向上するだけでなく、Lidの選択肢が増えることで設計自由度が増す（設計時間短縮）効果も得られます。

2. 業界最高水準のLid搭載精度により歩留りを向上

業界最高水準のLid搭載精度でLidズレ不良を削減いたします。

例) ワークサイズ□25mm未満 搭載精度±0.035mm

3. 高速封止により生産性を向上

10mm/sec.で両辺を接合し、生産性の向上が図れます。

例) □5mmパッケージ封止 約5.5sec

4. 様々な大きさのパッケージ、およびLid形状に対応

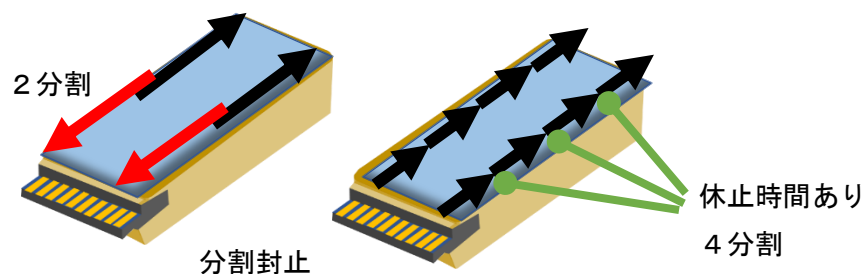
1台で□2mmから□150mmまでのシーム封止に対応いたします。

また、フラットLid、キャップLid、窓付きLidに対応致します。

5. 自在なプログラム設定によりワークダメージを軽減し接合品質を向上

シーム封止で一般的な周波数固定の概念を超えた当社独自のシーム封止専用電源で、波高値、時間を任意で設定できます。これにより、パッケージの応力を最小限に抑え、クラックやたわみの発生を削減します。また、必要最小限の熱で封止が可能のため、アウトガスの発生を抑制し、内部デバイスへの影響を減らします。

さらに溶接開始位置、終了位置を任意に座標指定することが可能で、蓄熱の大きい大型パッケージは分割封止して応力を最小限に留めクラックを抑制します。



6. 充実したカスタム対応

①生産量に応じてアニール*チャンバの処理能力、配置を選択でき、シーム溶接の待ち時間を減らし生産の効率化が図れます。

*アニール効果 パッケージあるいは Lid を真空中で加熱することにより吸着水分や接着剤中のガス、その他有機物を除去し、封止後のデバイス特性を維持します。

②パーティクル抑制

HEPA フィルタを追加することでダストの影響を最小限に抑制。加速度センサ、ミラーデバイス、イメージングデバイスに有効です。

③Lid 供給形態

トレイ供給（標準）のほかリッドカセット、パーツフィーダを選択できます。

【本件に関するお問い合わせ先】

電子機器営業本部 接合機器営業部

〒224-0053 横浜市都筑区池辺町 4475 番地

TEL : 045-930-3595 mail : product-mj@ml.avio.co.jp

URL : <http://www.avio.co.jp/>

<シーム封止のご相談承ります>

サンプル実験のご依頼や品質、タクトなどでのお困り事をご相談ください。

接合機器の営業拠点は新横浜事業所・中部支店（名古屋）・西日本支店（大阪）、福岡営業所の4箇所がございます。